



SIARAN MEDIA

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

MOSTI MEMPERKASA INDUSTRI SEMIKONDUKTOR PEMBUNGKUSAN TERMAJU (*ADVANCED PACKAGING*): SASAR TEROKAI 7% PASARAN GLOBAL MENJELANG 2035

PULAU PINANG, 8 MEI 2026 – Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) hari ini memperkukuh komitmen Kerajaan dalam memacu peralihan industri semikonduktor negara melalui lawatan kerja YB Datuk Chang Lih Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) ke fasiliti industri pembungkusan termaju (*advanced packaging*) di Pulau Pinang. Lawatan ini turut disertai oleh YB Tuan Haji Akmal Nasrullah Mohd Nasir, Menteri Ekonomi, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI), YB Tuan Sim Tze Tzin dan YBhg. Dato' Ts. Dr. K. Nagulendran, Ketua Setiausaha MOSTI.

Lawatan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh pelaksanaan projek penyelidikan dan pembangunan (*Research & Development - R&D*). Pembungkusan Termaju (*advance packaging*) di bawah program yang dibiayai Kumpulan Wang Amanah (KWA) Malaysia Science Endowment (MSE). Projek ini penting untuk meletakkan Malaysia sebagai salah satu destinasi utama pelaburan semikonduktor bernilai tinggi.

Kerajaan melalui KWA MSE telah meluluskan geran penyelidikan dan pembangunan (R&D) bernilai **RM92 juta** untuk tempoh 24 bulan bagi menjayakan program ini. Dana ini telah diagihkan kepada sebuah konsortium yang terdiri daripada lima syarikat peneraju tempatan dengan nilai padanan industri berjumlah **RM93.8 juta** menjadikan jumlah keseluruhan pelaburan R&D ini sebanyak **RM185.8 juta**.

Lima syarikat utama tersebut adalah:

- (i) **SkyeChip Berhad:** Berperanan dalam memacu reka bentuk cip HBM dan *chiplet 2.5D/3D*.
- (ii) **Inari Technology Sdn. Bhd.:** Membangunkan kapasiti rintis bagi pemasangan pembungkusan termaju.
- (iii) **FusionAP Sdn. Bhd.:** Syarikat pemula yang memfokuskan kepada pemindahan teknologi IP bernilai tinggi/bermutu tinggi (*high end IP*).
- (iv) **Pentamaster Instrumentation Sdn. Bhd.:** Membangunkan peralatan ujian automatik (ATE) dan *High-end Inspection*.
- (v) **NSW Automation Sdn. Bhd.:** Mempunyai kepakaran dalam sistem pendispensan cecair berketepatan tinggi (*sub-10µm*).

Meletakkan Malaysia sebagai Hab Neutral Global

YB Datuk Chang Lih Kang menegaskan bahawa kejayaan projek ini adalah kritikal bagi Malaysia dalam menjayakan Strategi Semikonduktor Kebangsaan (NSS). Tatkala **industri semikonduktor global diunjurkan mencecah nilai USD 1 trilion menjelang tahun 2030**, Malaysia sedang memacu peralihan daripada pemasangan tradisional kepada reka bentuk bernilai tinggi dan pembungkusan termaju. "Malaysia mempunyai asas semikonduktor selama 50 tahun dan **status geopolitik yang neutral**, menjadikannya hab yang paling ideal bagi pelabur yang mencari daya tahan rantaian bekalan (*supply chain resilience*) di luar China dan Taiwan."

Menurut YB Tuan Haji Akmal Nasrullah Mohd Nasir, di bawah RMK13, tumpuan Kerajaan adalah untuk memastikan Malaysia bergerak lebih tinggi dalam rantai nilai dengan tumpuan kepada industri pertumbuhan dan nilai yang tinggi (HGHV) antaranya melibatkan semikonduktor melalui pengukuhan R&D, automasi dan pembangunan bakat tempatan. Projek ini menunjukkan bagaimana dasar negara diterjemahkan kepada kerjasama industri yang nyata, bagi menarik pelaburan berkualiti, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi dan memberi pulangan ekonomi kepada negara.

Malaysia kini merupakan pengeksport semikonduktor keenam (6) terbesar di dunia dengan menyumbang sekitar 13% daripada aktiviti pemasangan, pengujian dan pembungkusan (ATP) global. Untuk memacu industri ini, Malaysia sedang beralih secara agresif ke arah *advanced packaging* bagi mengelakkan "perangkap margin rendah" (*low-margin trap*) akibat persaingan kos buruh dari negara serantau. Segmen *advanced packaging* menawarkan margin keuntungan yang lebih tinggi mencecah 40% hingga 50%, yang turut didorong oleh revolusi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence - AI*) global.

Program ini juga berfungsi sebagai platform peningkatan kemahiran bakat tempatan, mencipta lebih banyak peluang pekerjaan bernilai tinggi, merapatkan jurang antara industri dan akademia melalui pendedahan langsung kepada teknologi rintisan (*frontier technologies*). Program ini merupakan bukti usaha kerajaan MADANI untuk memastikan Malaysia menguasai **7% daripada pasaran pembungkusan termaju global menjelang tahun 2035.**

#TAMAT#

Disediakan oleh:

**KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
8 MEI 2026**

